

Bienvenue chez O-Leading

O-Leading s'efforce d'être votre partenaire de solution unique dans la chaîne d'approvisionnement EMS, y compris la conception de PCB, la fabrication de PCB et l'assemblage de PCB (PCBA). Nous fournissons certaines des technologies de PCB les plus avancées, y compris les PCB HDI, les PCB multicouches, les PCB rigides et flexibles. Nous pouvons prendre en charge du prototype à virage rapide à la production moyenne et en masse.

En général, nos clients mondiaux sont très impressionnés par nos services: une réponse rapide, un prix compétitif et un engagement en matière de qualité.

En regardant vers l'avenir, O-Leading se concentrera sur l'innovation et le développement de la technologie de fabrication électronique comme toujours, et déploiera des efforts persistants sur le service unique PCB & PCBA pour fournir des services de première classe et créer plus de valeur pour nos clients.

VEUILLEZ CLIQUER ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS: [chine Pcb design company](#)

Description du produit

Lieu d'origine	Guang dong, Chine (continentale)	Marque	O-leader
Matériel de base	FR-4, aluminium	Épaisseur de cuivre	0,5 oz-5 oz
Min. Taille du trou	0,2 mm	Min. Largeur de ligne	0,2 mm
Finition de surface	immersion or, OSP, sans plomb HASL	Épaisseur du panneau	0,1 à 5 mm
applicable à	led, téléphone portable, climatiseurs, machines à laver	personnage	PCB de contrôle industriel
certificats	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
poids	0,01 kg -5 kg	MOQ	10 pièces
Numéro de modèle	fabricant de pcba d'assemblage de carte de banque de puissance	Min. Interligne	0,2 mm
Couleur	bleu, rouge, vert, noir,jaune	prix	0,1 \$ à 10 \$
type de desigh	exigence du client	Taille	0,01 m3 à 10 m3

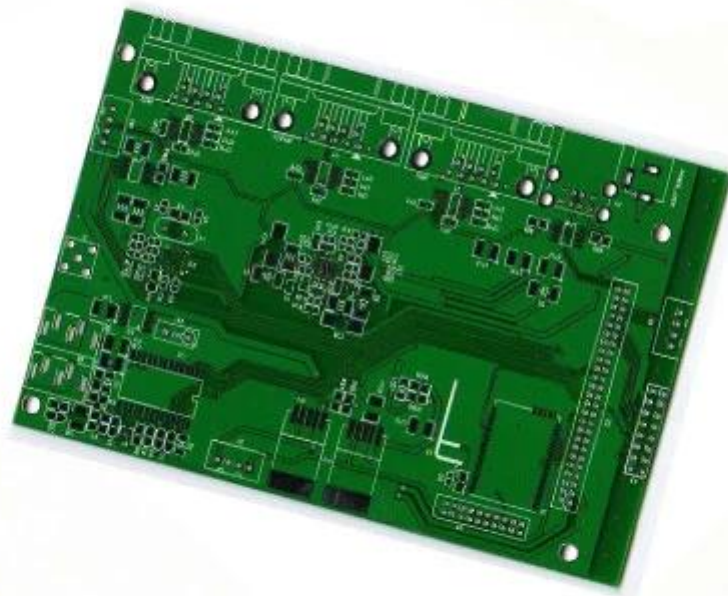
La capacité de production

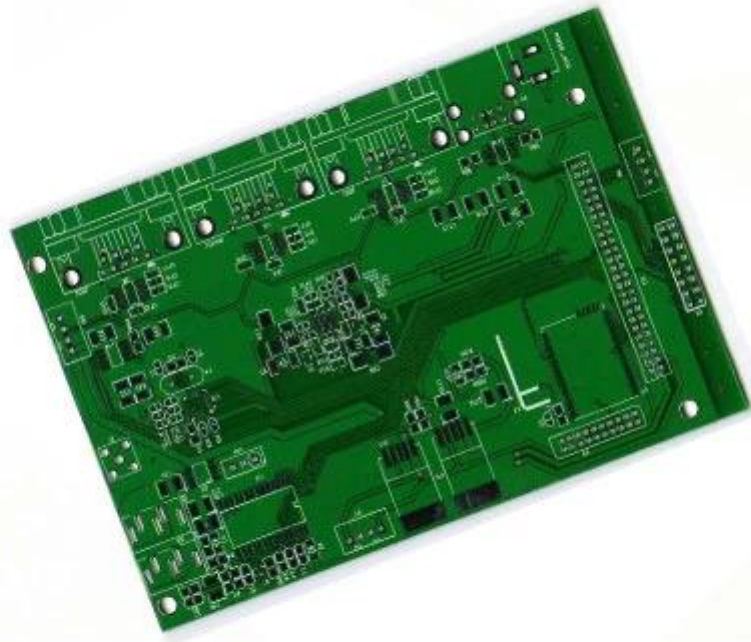
16 ans de fabrication professionnelle de circuits imprimés OEM

article	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Le volume	Échantillon	Le volume	Échantillon	Le volume	Échantillon
Nombre de couches	32	42	38	44	42	48
Ligne min / espace (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Trou de forage minimum diamètre (mm)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Ratio d'aspect de PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1

N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Interconnexion de n'importe quelle couche	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Remplissage de plaque via	OUI	-	OUI	-	OUI	-
Min. épaisseur du noyau (à l'exclusion du cuivre) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Diamètre de perçage laser (µm)	75	65	65	50	50	40
Via sur enterré trou / empilé via	OUI	-	OUI	-	OUI	-
Matériel	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper, etc.					
PCB de condensateur intégré	OUI	-	OUI	-	OUI	-
Processus de surface	HASL sans plomb, ENIG, OSP, Argent d'immersion, Étain d'immersion, Or flash, plaqué or, plaqué or dur sélectif, Masque de soudure pelable, Carbon ink					







www.o-leading.com

[pcb board Imprimé entreprise chine](#)

Notre équipe



Factory PCB



Automatic vacuum press machine



Drilling Machine



Pattern Plating Machine



Scrubbing Machine



Developing Machine



Routing Machine



High-speed flying probe machine



E-test Machine

Factory SMT



Certifications

CICC INSPECTION CERTIFICATION



嘉泰认证

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No: 18118Q10347R05

We hereby certify that

O-LEADING SUPPLY CHAIN(HK) CO.,LIMITED

Credit No: 61691591-000-07-18-7

Registration Add: FLAT/RM 1205 12/F TAI SANG BANK BUILDING 130-132 DES VODEUS ROAD CENTRAL HK

Business Add: 1213, Floor 13, Fortune Building, Danshui Town, Huiyang District, Huizhou, Guangdong, China

Has implemented and maintains a **Quality Management System** Which fulfills the requirements of the following standards
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

Scope of certification
Sales of printed circuit boards

Initial issuance period: February 27, 2018
Renewal date: April 22, 2019
This certificate is valid during: April 22, 2019 – February 26, 2021
This certificate is invalid without CICC qualified label in the following period

First supervision and audit	Second supervision and audit	Qualified mark
-----------------------------	------------------------------	----------------

The certification registration number does not include those production stages which fail to be covered by the relevant effective administrative procedures and qualification procedures mentioned in the scope. The effectiveness of this certificate shall be restricted to actual surveillance scope of CICC. The certificate shall be valid when used together with the qualified mark issued.

The initial issuance of this certification can be searched on the portal of CICC www.cicc.com.cn by the code of inquiry www.cicc.com.cn.






CICC INSPECTION CERTIFICATION



嘉泰认证

质量管理体系认证证书

证书号: 18118Q10347R05

兹证明

诚领供应链(香港)有限公司

统一社会信用代码: 61691591-000-07-18-7

注册地址: 香港中環德輔道中130-132號大生銀行大廈1205室

经营地址: 广东惠州惠阳淡水南亨西路财富大厦13楼1313

建立的质量管理体系符合
GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 质量标准适用条款的要求

认证范围
印刷线路板的销售

初次获证日期: 2018年02月27日
换证日期: 2019年04月22日
证书有效期: 自2019年04月22日至2021年02月26日
在下列期限内, 未经CICC黏贴合格标贴, 本证书无效

第一次监督	第二次监督	黏贴处
-------	-------	-----

本证书认证范围不包括未取得有效的国家规定的行政许可、资质许可的产品/服务范围; 本证书通过CICC定期监督审核保持, 与年度《保持认证通知书》共同方为有效; 本证书信息可在国家认监委网站: www.cnca.gov.cn及CICC网站www.cicc.com.cn。








ZPMV2.E490354 - WIRING, PRINTED - COMPONENT

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Component

O-LEADING SUPPLY CHAIN (HK) CO LTD

E490354

ROOM 1205, 12/F
TAI SANG BANK BLDG
130-132 DES VOEUS ROAD
CENTRAL, HONG KONG

Type	Cond Width		Cond Thk	SS/ DS/ DSO	Max	Max		Meets	C			
	Min	Edge			Area	Solder	Oper			Flame		
	mm(in)	mm(in)	mic(mil)		mm(in)	C	sec	C	Class	UL796	DSR	I
Multilayer (mass laminate) printed wiring boards.												
O-LEADING-401	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	12.7 (0.5)	260	10	130	V-0	-	-	
O-LEADING-407	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	DS	9.7 (0.4)	260	10	130	V-0	All	-	
Multilayer printed wiring boards.												
O-LEADING-408	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47) Int:136	DS	50.8 (2.0)	280	20	130	V-0	All	*	
Single layer printed wiring boards.												
O-LEADING-002	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	All	-	
O-LEADING-003	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	SS	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	▲	-	
O-LEADING-033	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	All	-	
O-LEADING-205	0.1 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-	
O-LEADING-206	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	DS	69.6 (2.7)	260	10	130	V-0	All	-	
O-LEADING-D01	0.14 (0.006)	0.15 (0.006)	33 (1.30)	DS	25.4 (1.0)	260	10	130	V-0	All	*	
O-LEADING-S01	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*	

WIRING, PRINTED - COMPONENT | UL Product iQ

O-LEADING-S02	0.2 (0.008)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	HB	▲	*	
O-LEADING-S03	0.25 (0.010)	0.25 (0.010)	34 (1.34)	SS	25.4 (1.0)	260	4	130	V-0	All	*	

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Marking: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test classification.

并不是所有出现在本数据库中的公司名称和产品都满足了UL跟踪检验服务的要求。只有带有UL标志的产品，才应该被视为经过UL认证，并满足UL跟踪检验服务的要求。注意查看产品上的标志。

UL 允许在线认证目录中所含材料的复制遵循以下条件：1.指南信息、装配、构造、设计、系统和/或认证（文件）必须在不篡改任何数据（或图纸）的情况下完整且无误导性地呈现。2.经UL允许从在线认证目录转载“声明必须出现在所提取材料的邻近位置。此外，转载材料必须包含以下格式的版权声明：“© 2019 UL LLC”

Shipping service



Quick Turn Lead Time		
Layer Count:	Lead Tim	Special Requirement
1L/2L	2-3days	24 Hours,48 Hours
4L	3-4days	48 Hours
6L	4-5days	72 Hours
8L	5-6days	NA
10L	6-7days	NA
12L	7-8days	NA
14L	8-9days	NA

Standard Lead Time		
Layer Count:	Sample Lead Time	Volume order lead time
2L	4 days	10 days
4L	5 days	11 days
6L	6 days	12 days
8L	8 days	14 days
10L	10 days	16 days
12L	12 days	18 days
14L	14 days	20 days
16-32L	18 days	24 days

Capacité du processus

Capacités de production de PCB

Nombre de couches: 1 couche-32 couches

Épaisseur de cuivre fini: 1 / 3oz-12oz

Largeur / espacement des lignes min. Interne: 3.0mil / 3.0mil

Largeur / espacement des lignes min externes: 4.0mil / 4.0mil

Rapport d'aspect max: 10: 1

Épaisseur du panneau: 0,2 mm à 5,0 mm

Taille maximale du panneau (pouces): 635 * 1500 mm

Taille minimale du trou percé: 4mil

Tolérance de trou Plated: +/- 3mil

Blind / Buried Vias (types All): OUI

Via remplissage (conducteur, non conducteur): OUI

Matériau de base: FR-4, FR-4High Tg.Halogen free material, Rogers, Aluminium base,Polyimide,

Cuivre lourd

Finitions de surface: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, Immersion silver,Étain d'immersion, doigts d'or, encre de carbone

Capacités de production SMT

Matériau PCB: FR-4, CEM-1, CEM-3, carte à base d'aluminium

Taille maximale du PCB: 510x460mm

Taille minimale du PCB: 50x50mm

Épaisseur du PCB: 0,5 mm à 4,5 mm

Épaisseur du panneau: 0,5-4 mm

Taille minimale des composants: 0201

Composant de taille de puce standard: 0603 et plus

Hauteur maximale des composants: 15 mm

Pas de plomb mini: 0,3 mm

Pas de balle BGA minimum: 0,4 mm

Précision de placement: +/- 0,03 mm